公司代码：688082　　公司简称：盛美上海

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在2026年半年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	盛美上海	688082	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	罗明珠	/
电话	021-50276506	/
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋	/
电子信箱	ir@acmrcsh.com	/

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	20,736,044,888.58	18,894,894,681.46	9.74
归属于上市公司股东的净资产	14,606,607,055.79	13,469,590,277.25	8.44
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	3,718,097,074.64	3,265,291,841.84	13.87
利润总额	1,140,602,280.67	820,349,219.58	39.04
归属于上市公司股东的净利润	988,949,356.41	695,772,727.73	42.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	571,026,041.89	674,279,774.93	-15.31
经营活动产生的现金流量净额	88,065,362.79	-131,953,945.43	不适用
加权平均净资产收益率（%）	7.06	8.62	减少1.56个百分点
基本每股收益（元／股）	2.06	1.58	30.38
稀释每股收益（元／股）	2.04	1.57	29.94
研发投入占营业收入的比例（%）	17.82	16.67	增加1.15个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）	24,268
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
ACM RESEARCH, INC.	境外法人	73.12	352,890,660	0	0	无	
上海浦东新兴产业投资有限公司	国有法人	2.69	12,982,822	0	0	无	
中国农业银行股份有限公司－东方人工智能主题混合型证券投资基金	其他	1.16	5,585,110	0	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	1.05	5,048,261	0	0	无	
长江证券股份有限公司－华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61	2,945,510	0	0	无	
广发证券股份有限公司－国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.56	2,718,059	0	0	无	
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55	2,641,831	0	0	无	
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45	2,184,411	0	0	无	
中国建设银行股份有限公司－银华集成电路混合型证券投资基金	其他	0.43	2,052,584	0	0	无	
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33	1,611,565	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688082　　证券简称：盛美上海　　公告编号：2026-037

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2026年8月6日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定和公司2022年年度股东大会授权，公司董事会同意对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格进行调整。现将相关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2023年4月26日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）2023年6月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-024），根据公司其他独立董事的委托，独立董事张苏彤先生作为征集人就公司2022年度股东大会审议的2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2023年5月9日至2023年5月18日，公司在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计10天，公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。具体内容详见公司于2023年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（四）2023年6月28日，公司召开2022年度股东大会审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。股东大会批准公司实施本激励计划，授权董事会确定限制性股票授予日，并在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。具体内容详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。具体内容详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（五）2023年8月3日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（六）2024年6月25日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2024年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（七）2024年10月29日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等议案。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（八）2025年8月5日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等议案。具体内容详见公司于2025年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（九）2026年2月26日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等议案。具体内容详见公司于2026年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（十）2026年8月6日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》等议案。具体内容详见公司于2026年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、本次调整的主要内容

（一）调整事由

公司于2026年6月16日召开2025年年度股东会，审议并通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有公司股份后的股本总额为基数进行利润分配。截至2025年12月31日，公司总股本为480,164,789股，以剔除已回购股份443,400股后的总股本为基准，拟每10股派发现金红利6.233元（含税）。公司于2026年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整2025年度利润分配方案每股分红金额的公告》（公告编号：2026-032），因公司总股本由480,164,789股增加至482,596,689股，公司2025年度利润分配方案每股派发现金红利由0.6233元（含税）调整为0.62016元（含税），上述权益分派已于2026年7月31日实施完毕。因存在差异化分红，调整后虚拟分派的现金红利为0.61959元/股。

根据公司《激励计划》第十章第二条规定，激励计划公告日至激励对象获授限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

根据公司《激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下：

P＝P0－V

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

根据以上公式，本激励计划调整后的授予价格=81.59-0.61959=80.97元/股（四舍五入保留两位小数）。

（二）激励对象名单及限制性股票授予数量的调整

鉴于本激励计划涉及的12名激励对象因离职等个人原因已不符合激励对象资格，前述激励对象涉及限制性股票数量为5.29万股。公司董事会根据2025年年度股东会的授权，对《激励计划》激励对象人数及限制性股票授予数量进行调整。本次调整后，本激励计划的激励对象人数由520人调整为508人，因离职不再符合激励对象条件的激励对象原获授限制性股票数量作废失效，本激励计划授予的限制性股票数量由208.3720万股调整为203.0820万股。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2025年年度股东会审议通过的内容一致。

根据公司2025年年度股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2026年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时也不会影响公司核心团队的稳定性和股权激励计划的继续实施，确保了公司激励机制的持续有效。

四、专项意见说明

（一）薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为：公司本次对2026年限制性股票激励计划授予价格、授予数量、激励对象名单等相关事项进行调整，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司2025年年度股东大会授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会已审议并一致同意将2026年限制性股票激励计划授予价格由81.59元/股调整为80.97元/股、对授予数量、激励对象名单进行调整，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）律师法律意见书的结论意见

北京市金杜律师事务所上海分所认为：截至本法律意见书出具日，本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。

五、上网公告附件

《北京市金杜律师事务所上海分所关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司2026年限制性股票激励计划调整授予价格、激励对象名单、授予数量及向激励对象授予限制性股票相关事项之法律意见书》。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2026年8月8日

证券代码：688082　　证券简称：盛美上海　　公告编号：2026-035

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年8月6日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“盛美上海”）第三届董事会第六次会议在中国（上海）自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋会议室举行，本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

会议由董事长HUI WANG先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-036）。

（三）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。委员王坚回避表决。

表决情况：6票赞成，占无关联关系董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

董事HUI WANG、王坚、杨霞云对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-037）。

（四）审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。委员王坚回避表决。

表决情况：6票赞成，占无关联关系董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

董事HUI WANG、王坚、杨霞云对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-038）。

（五）审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。委员王坚回避表决。

表决情况：6票赞成，占无关联关系董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

董事HUI WANG、王坚、杨霞云对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-039）。

（六）审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。委员王坚回避表决。

表决情况：6票赞成，占无关联关系董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

董事HUI WANG、王坚、杨霞云对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-039）。

（七）审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：8票赞成，占无关联关系董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

董事杨霞云对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-040）。

（八）审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：8票赞成，占无关联关系董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

董事杨霞云对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-041）。

（九）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任李学军先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审核通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十）审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2026年8月8日

附件：李学军先生简历

李学军：男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气自动化专业学士。2009年5月至2020年4月历任盛美上海售后服务经理、高级经理、售后服务总监，现任盛美上海售后服务高级副总裁，负责为客户提供技术服务及售后服务团队建设。参与半导体清洗设备相关技术研发及专利申请，为公司主要客户提供产品技术支持和解决方案，专注提升客户生产效率和产品良率。

截至本公告披露日，李学军直接持有公司股份141,346股。李学军与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码：688082　　证券简称：盛美上海　　公告编号：2026-036

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1、2021年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意盛美半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2689号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）43,355,753股，发行价格为85.00元/股，募集资金总额为人民币3,685,239,005.00元，扣除承销商保荐及承销费用人民币173,832,028.54元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币30,148,456.12元（包括：审计费及验资费12,467,000.00元、律师费10,904,467.37元、用于本次发行的信息披露费用4,575,471.70元、发行手续费及材料制作费等2,201,517.05元），募集资金净额为人民币3,481,258,520.34元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZI10561号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2021年11月12日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	368,523.90
其中：超募资金金额	171,141.07
减：直接支付发行费用	20,398.05
二、募集资金净额	348,125.85
减：	
以前年度已使用金额	313,760.65
本年度使用金额	9,184.16
银行手续费支出及汇兑损益	28.66
永久补充流动资金	37,146.68
加：	
募集资金利息收入	11,994.30
三、报告期期末募集资金余额	0.00

2、2024年度向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意盛美半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1338号）核准，公司于2025年9月完成向特定对象发行人民币普通股（A股）38,601,326股，发行价格为116.11元/股，募集资金总额为人民币4,481,999,961.86元，扣除各项发行费用人民币46,984,264.81元（不含增值税），募集资金净额为人民币4,435,015,697.05元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2025]第ZI10808号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2025年9月16日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	448,200.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	4,698.43
二、募集资金净额	443,501.57
减：	
以前年度已使用金额	113,934.18
本年度使用金额	57,560.84
现金管理金额	230,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	6.85
加：	
募集资金利息收入	65.82
三、报告期期末募集资金余额	42,065.52

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、管理与使用均不存在违反《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

1、2021年首次公开发行股票

2021年11月，公司和保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司）分别与招商银行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海昌里支行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、上海银行股份有限公司浦东分行、招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行、上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行、招商银行股份有限公司上海淮海支行、兴业银行股份有限公司上海市北支行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行、中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司盛帷半导体设备（上海）有限公司和保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司）与招商银行股份有限公司上海分行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年10月，公司和保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司）与上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。2024年6月，公司及全资孙公司ACM RESEARCH KOREA CO., LTD.和保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司）与KB Kookmin Bank Seongnam Hi-tech valley Branch共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年6月30日，上述账户已全部销户。

2、2024年度向特定对象发行股票

2025年9月，公司和保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、中国光大银行股份有限公司上海昌里支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司盛帷半导体设备（上海）有限公司与国泰海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年6月30日，上述监管协议履行正常。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024年度向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2025年9月16日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
盛美半导体设备（上海）股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行	458548927208	11,702.52	使用中
盛帷半导体设备（上海）有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121938866210008	30,335.05	使用中
盛美半导体设备（上海）股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区新片区供数路支行	1001740619300212673	0.74	使用中
盛美半导体设备（上海）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行陆家嘴支行	121909929210018	9.78	使用中
盛美半导体设备（上海）股份有限公司	上海银行股份有限公司张江支行	03006344991	3.23	使用中
盛美半导体设备（上海）股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海昌里支行	36750180800806631	14.20	使用中
合计			42,065.52	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附表2《2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年6月26日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行临时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）。2026年5月20日，公司已将上述临时补充流动资金的全部249,999,701.17元闲置募集资金归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月，具体内容详见公司于2026年5月22日在上海证券交易所网站披露的《关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-020）。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股票			
募集资金到账时间		2021年11月12日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
24,999.97	2025年6月26日	12个月	2025年6月26日	2026年5月20日	24,999.97

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年8月5日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币1.00亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年8月7日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-059）。

公司于2025年10月28日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币24亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-077）。

截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2021年11月12日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
10,000.00	投资产品	2025年8月5日	2026年8月4日	2025年8月5日

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024年度向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2025年9月16日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
240,000.00	投资产品	2025年10月28日	2026年10月27日	2025年10月28日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股票						
募集资金到账时间			2021年11月12日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
盛美半导体设备（上海）股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海市北支行	大额存单	大额存单	9,000.00	2023年1月31日	2026年1月31日	2026年1月31日	无	3.15%	850.50

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024年度向特定对象发行股票							
募集资金到账时间			2025年9月16日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
盛美半导体设备（上海）股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行	大额存单	大额存单	180,000.00	2025年12月24日	2026年12月24日	未到期	未到期	1.20%	未到期
盛帷半导体设备（上海）有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	大额存单	大额存单	50,000.00	2025年11月14日	2026年11月14日	未到期	未到期	1.40%	未到期

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2026年5月26日召开第三届董事会审计委员会2026年第三次会议和第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“盛美半导体设备研发与制造中心”项目节余募集资金8,356.73万元，以及首次公开发行股票剩余超募资金28,842.24万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。本事项于2026年6月16日经公司2025年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于2026年5月27日、2026年6月17日在上海证券交易所网站披露的《关于使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-026）及《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-031）。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股票		
募集资金到账时间	2021年11月12日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	28,843.92	2026年5月26日	2026年6月16日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2026年5月26日召开第三届董事会审计委员会2026年第三次会议和第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“盛美半导体设备研发与制造中心”项目节余募集资金8,356.73万元，以及首次公开发行股票剩余超募资金28,842.24万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。本事项于2026年6月16日经公司2025年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于2026年5月27日、2026年6月17日在上海证券交易所网站披露的《关于使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-026）及《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-031）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股票				
募集资金到账日期			2021年11月12日				
节余募集资金合计金额			8,302.75				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期